

<<印制电路技术>>

图书基本信息

书名：<<印制电路技术>>

13位ISBN编号：9787502521592

10位ISBN编号：7502521593

出版时间：2003-12

出版单位：化学工业

作者：金鸿

页数：304

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<印制电路技术>>

内容概要

《印制电路技术》收集了国内外有关印制电路制造的新资料，并在此基础上结合作者精密电子电路技术专业多年的教学经验，经过认真准备后完成了本书的编写工作。

书中阐述了印制电路技术的基本概念、原理和工艺，以及最新的印制板制造工艺和技术。

涵盖了各类印制板制造所必须掌握的基础知识和实际知识，力求实现科学性、先进性、新颖性和实用性的统一。

本书可作为精密电子电路技术、印制电路技术、工业工程和电子类等专业的专业课教材，除此之外，还可以作为企业印制电路从业人员的短期培训教材。

<<印制电路技术>>

书籍目录

第一章 印制电路概论第一节 印制电路基本概念第二节 印制电路制造工艺第三节 印制电路历史第四节 印制电路的发展动向第五节 其他类型印制板第二章 印制板用基板材料第一节 概述第二节 覆铜箔层压板的主要原材料第三节 纸基覆铜板第四节 环氧玻纤布覆铜板第五节 复合基覆铜板第六节 几种高性能覆铜板第三章 光绘与制版第一节 制作照相底图第二节 光绘数据格式第三节 制版工艺第四章 印制电路板机械加工第一节 概述第二节 数控钻第三节 数控铣第四节 激光钻孔第五章 印制电路化学工艺第一节 化学沉铜第二节 电镀铜第三节 电镀Sn/Pb合金第四节 电镀镍金第五节 蚀刻工艺第六章 印制电路光致成像工艺第一节 光致抗蚀干膜及光致成像第二节 液体光致抗蚀剂第七章 丝网印刷工艺第一节 丝网准备第二节 感光制版第三节 印料第四节 丝网印刷工艺第八章 多层印刷电路制造技术第一节 多层板材料第二节 定位系统第三节 多层板层压第四节 凹蚀第九章 印制电路可焊性处理第一节 热风整平第二节 有机可焊性保护剂第三节 化学镀镍金第四节 化学镀钯第十章 柔性电路制造技术第一节 柔性电路第二节 柔性电路材料第三节 双面柔性印制制造工艺第四节 多层刚柔性印制板的制造第十一章 高密度印制板 (HDI) 制造技术第一节 HDI的由来及特点第二节 HDI的工艺流程第三节 HDI的材料和工艺第十二章 电路板生产废水处理技术第一节 印制电路板生产中的三废第二节 电路板生产废水处理技术附录 印制电路技术英中文词汇对照表参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>